



ASE GROUP

日月光投資控股 2021年 第四季 法人說明會

日月光投資控股股份有限公司
February 10, 2022



Safe Harbor Notice

This presentation contains "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the United States Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the United States Securities Exchange Act of 1934, as amended. Although these forward-looking statements, which may include statements regarding our future results of operations, financial condition or business prospects, are based on our own information and information from other sources we believe to be reliable, you should not place undue reliance on these forward-looking statements, which apply only as of the date of this press release. The words "anticipate," "believe," "estimate," "expect," "intend," "plan" and similar expressions, as they relate to us, are intended to identify these forward-looking statements in this press release. These forward-looking statements are necessarily estimates reflecting the best judgment of our senior management and our actual results of operations, financial condition or business prospects may differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements for reasons including, among others, risks associated with cyclicity and market conditions in the semiconductor or electronic industry; changes in our regulatory environment, including our ability to comply with new or stricter environmental regulations and to resolve environmental liabilities; demand for the outsourced semiconductor packaging, testing and electronic manufacturing services we offer and for such outsourced services generally; the highly competitive semiconductor or manufacturing industry we are involved in; our ability to introduce new technologies in order to remain competitive; international business activities; our business strategy; our future expansion plans and capital expenditures; the strained relationship between the Republic of China and the People's Republic of China; general economic and political conditions; the recent shift in United States trade policies; possible disruptions in commercial activities caused by natural or human-induced disasters; fluctuations in foreign currency exchange rates; and other factors. For a discussion of these risks and other factors, please see the documents we file from time to time with the Securities and Exchange Commission, including the 2020 Annual Report on Form 20-F filed on April 6, 2021.

合併綜合損益表

(未經會計師查核)

(新台幣百萬元)	Q4 / 2021	%	Q3 / 2021	%	Q4 / 2020	%	季變化	年變化
營業收入淨額:								
半導體封測事業	90,583	52.4%	88,791	58.9%	69,135	46.4%	2%	31%
電子代工服務	81,541	47.2%	61,116	40.6%	79,141	53.2%	33%	3%
其它	812	0.4%	758	0.5%	601	0.4%	7%	35%
營業收入淨額合計	172,936	100.0%	150,665	100.0%	148,877	100.0%	15%	16%
營業毛利	32,894	19.0%	30,784	20.4%	23,299	15.6%	7%	41%
營業淨利 (淨損)	19,615	11.3%	18,426	12.2%	11,246	7.6%	6%	74%
稅前淨利 (淨損)	37,336	21.6%	18,474	12.3%	12,604	8.5%	102%	196%
所得稅利益 (費用)	(5,592)	-3.2%	(3,630)	-2.4%	(1,839)	-1.2%		
非控制權益	(828)	-0.5%	(668)	-0.4%	(721)	-0.5%		
歸屬於本公司業主之淨利	30,916	17.9%	14,176	9.4%	10,044	6.7%	118%	208%
基本每股盈餘 (新台幣元)	7.20		3.29		2.35		119%	206%
稀釋每股盈餘 (新台幣元)	6.99		3.20		2.30		118%	204%

管理階層補充說明^{1&2}:

營業毛利 - 不含購買價格分攤費用	33,819	19.6%	31,716	20.3%	24,184	16.2%	7%	40%
營業淨利 - 不含購買價格分攤費用	20,802	12.0%	19,620	11.3%	12,383	8.3%	6%	68%
淨利 - 不含購買價格分攤費用	32,105	18.6%	15,374	9.1%	11,239	7.5%	109%	186%
基本每股盈餘 (新台幣元) - 不含購買價格分攤費用	7.48		3.56		2.63		110%	184%

¹:購買價格分攤費用係日月光半導體和矽品換股案會計處理認列之購買溢價，分攤至不動產、廠房及設備、無形資產及使用權資產，使資產價值增加而產生之損益影響。

排除購買價格分攤產生之折舊、攤銷及其他費用，於2021年第4季為新台幣11.4億，2021年第3季為新台幣11.5億，2020年第4季為新台幣12.0億。

²:購買價格分攤費用係環電收購Asteelflash會計處理認列之購買溢價，分攤至不動產、廠房及設備、無形資產、使用權資產及遞延所得稅負債，使資產或負債價值增加而產生之損益影響。排除購買價格分攤產生之折舊、攤銷、其它費用、所得稅利益及歸屬於非控制權益之淨利，於2021年第4季為新台幣0.7億及2021年第3季為新台幣0.6億。

合併綜合損益表

(未經會計師查核)

(新台幣百萬元)	FY / 2021	%	FY / 2020	%	年變化
營業收入淨額:					
半導體封測事業	327,718	57.5%	270,095	56.6%	21%
電子代工服務	239,488	42.0%	204,691	42.9%	17%
其它	2,791	0.5%	2,192	0.5%	27%
營業收入淨額合計	569,997	100.0%	476,978	100.0%	20%
營業毛利	110,369	19.4%	77,984	16.3%	42%
營業淨利 (淨損)	62,125	10.9%	34,877	7.3%	78%
稅前淨利 (淨損)	80,336	14.1%	35,734	7.5%	125%
所得稅利益 (費用)	(14,322)	-2.5%	(6,457)	-1.4%	
非控制權益	(2,106)	-0.4%	(1,684)	-0.4%	
歸屬於本公司業主之淨利	63,908	11.2%	27,593	5.8%	132%
基本每股盈餘 (新台幣元)	14.84		6.47		129%
稀釋每股盈餘 (新台幣元)	14.40		6.31		128%

管理階層補充說明^{1&2}:

營業毛利 - 不含購買價格分攤費用	114,184	20.0%	81,692	17.1%	40%
營業淨利 - 不含購買價格分攤費用	66,996	11.8%	39,597	8.3%	69%
淨利 - 不含購買價格分攤費用	68,734	12.1%	32,414	6.8%	112%
基本每股盈餘 (新台幣元) - 不含					
購買價格分攤費用	15.96		7.60		110%

1:購買價格分攤費用係日月光半導體和矽品換股案會計處理認列之購買溢價，分攤至不動產、廠房及設備、無形資產及使用權資產，使資產價值增加而產生之損益影響。排除購買價格分攤產生之折舊、攤銷及其他費用，於2021年為新台幣46.1億，2020年為新台幣48.2億。

2:購買價格分攤費用係環電收購Asteelflash會計處理認列之購買溢價，分攤至不動產、廠房及設備、無形資產、使用權資產及遞延所得稅負債，使資產或負債價值增加而產生之損益影響。排除購買價格分攤產生之折舊、攤銷、其它費用、所得稅利益及歸屬於非控制權益之淨利，於2021年為新台幣3.0億。

綜合損益表 – 半導體封裝測試

(未經會計師查核)

(新台幣百萬元)	Q4 / 2021	%	Q3 / 2021	%	Q4 / 2020	%	季變化	年變化
營業收入淨額:								
封裝	76,664	83.4%	75,221	83.5%	60,825	83.6%	2%	26%
測試	13,756	15.0%	13,416	14.9%	10,667	14.7%	3%	29%
材料直接銷售	1,502	1.6%	1,429	1.6%	1,229	1.7%	5%	22%
其它	36	0.0%	26	0.0%	31	0.0%	38%	16%
營業收入淨額合計	91,958	100.0%	90,092	100.0%	72,752	100.0%	2%	26%
營業毛利	25,741	28.0%	24,714	27.4%	16,478	22.6%	4%	56%
營業淨利 (淨損)	16,056	17.5%	15,631	17.3%	8,002	11.0%	3%	101%

管理階層補充說明¹:

營業毛利 - 不含購買價格分攤費用	26,620	28.9%	25,594	28.4%	17,363	23.9%	4%	53%
營業淨利 - 不含購買價格分攤費用	17,185	18.7%	16,761	18.6%	9,139	12.6%	3%	88%

¹購買價格分攤費用係日月光半導體和矽品換股案會計處理認列之購買溢價，分攤至不動產、廠房及設備、無形資產及使用權資產，使資產價值增加而產生之損益影響。排除購買價格分攤產生之折舊及攤銷，於2021年第4季及2021年第3季均為新台幣11.3億，2020年第4季為新台幣11.4億。

綜合損益表 – 半導體封裝測試

(未經會計師查核)

(新台幣百萬元)	FY / 2021	%	FY / 2020	%	年變化
營業收入淨額:					
封裝	279,365	83.4%	228,574	81.5%	22%
測試	49,981	14.9%	47,277	16.9%	6%
材料直接銷售	5,346	1.6%	4,314	1.5%	24%
其它	113	0.1%	132	0.1%	-14%
營業收入淨額合計	334,805	100.0%	280,297	100.0%	19%
營業毛利	88,672	26.5%	59,434	21.2%	49%
營業淨利 (淨損)	53,432	16.0%	27,609	9.8%	94%

管理階層補充說明¹:

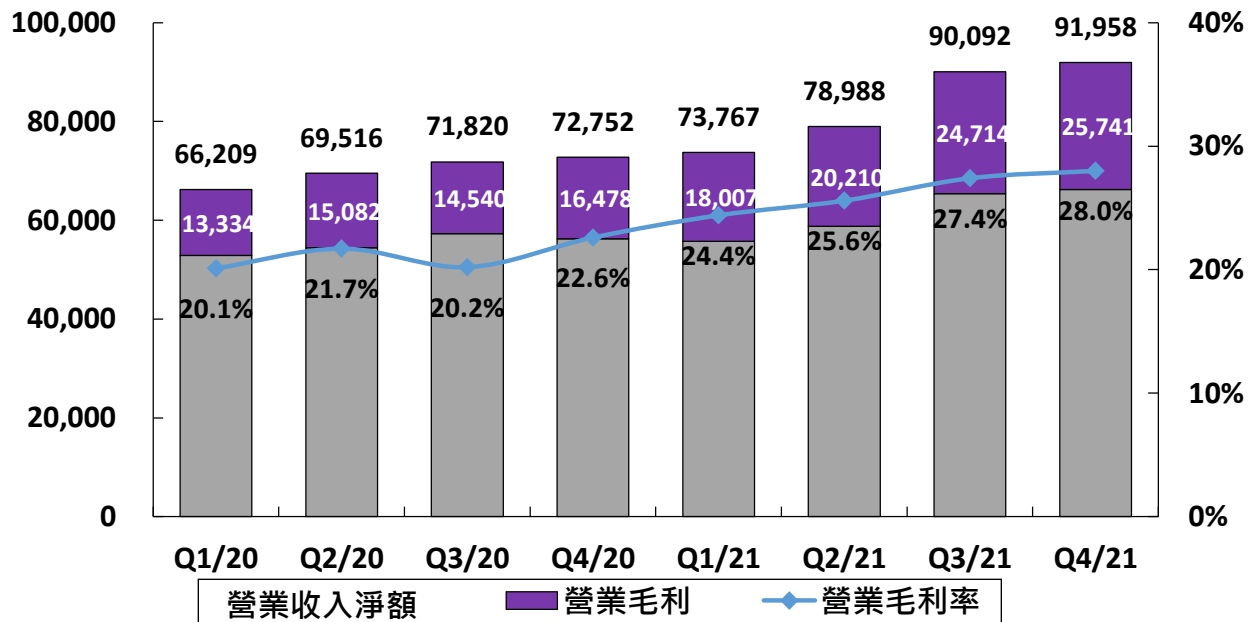
營業毛利 - 不含購買價格分攤費用 ¹	92,194	27.5%	63,142	22.5%	46%
營業淨利 - 不含購買價格分攤費用 ¹	57,958	17.3%	32,329	11.5%	79%

¹購買價格分攤費用係日月光半導體和矽品換股案會計處理認列之購買溢價，分攤至不動產、廠房及設備、無形資產及使用權資產，使資產價值增加而產生之損益影響。排除購買價格分攤產生之折舊、攤銷及其他費用，於2021年為新台幣45.3億，2020年為新台幣47.2億。

半導體封測業務

(未經會計師查核)

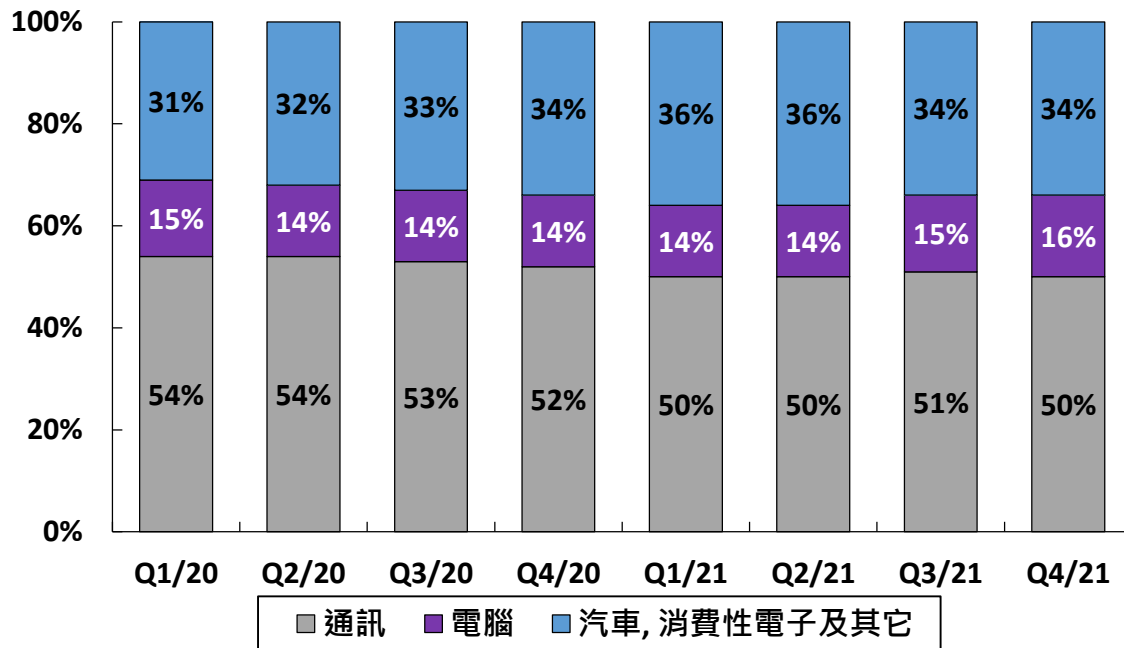
新台幣百萬元



半導體封測營收

產品應用別佔比

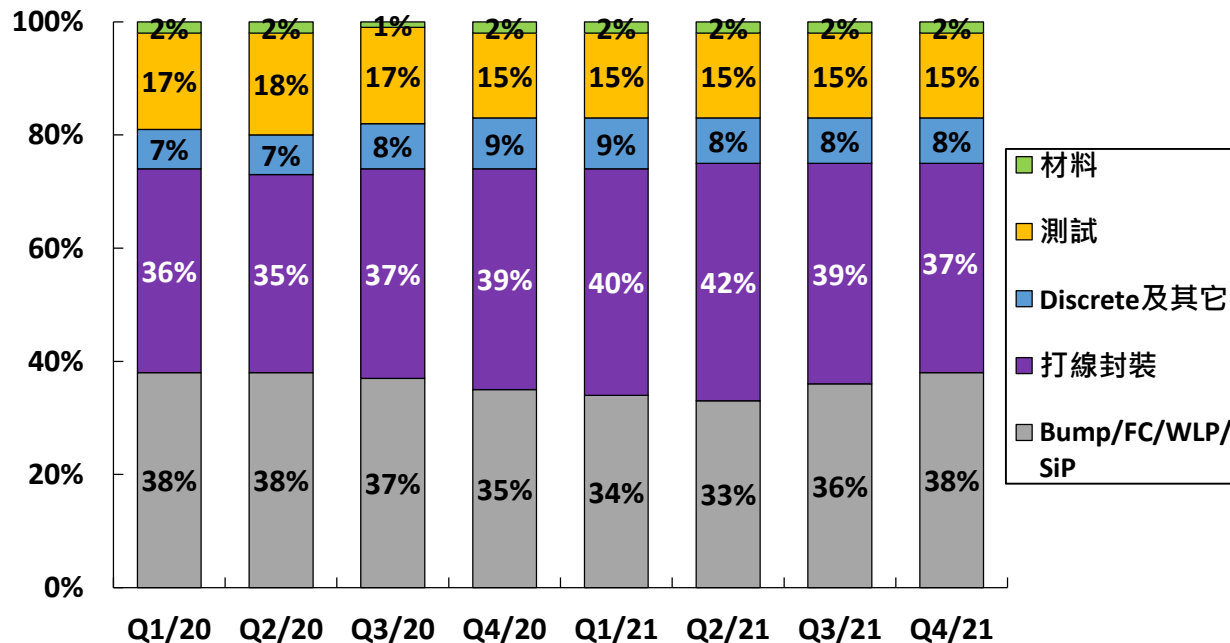
(未經會計師查核)



半導體封測營收

封測業務產品組合

(未經會計師查核)



綜合損益表 – 電子代工服務

(未經會計師查核)

(新台幣百萬元)	Q4 / 2021*	%	Q3 / 2021*	%	Q4/2020	%	季變化	年變化
電子代工服務營業收入淨額	81,544	100.0%	61,127	100.0%	79,149	100.0%	33%	3%
營業毛利	7,108	8.7%	5,883	9.6%	6,996	8.8%	21%	2%
營業淨利 (淨損)	3,599	4.4%	2,658	4.3%	3,463	4.4%	35%	4%

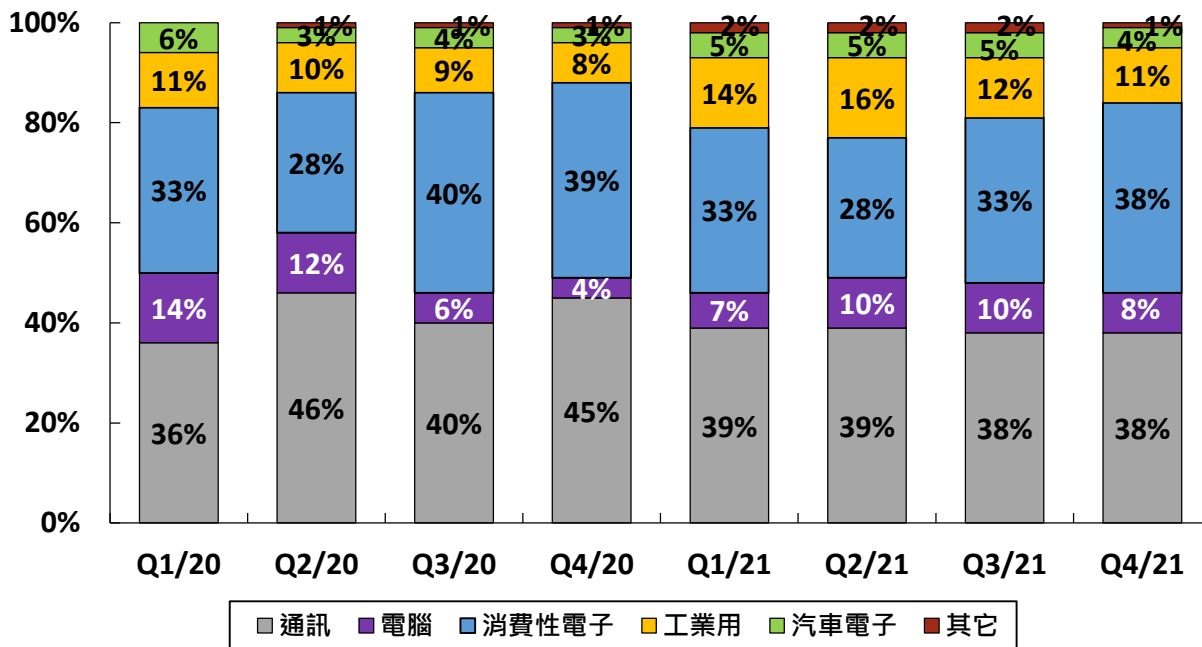
(新台幣百萬元)	FY / 2021*	%	FY / 2020	%	年變化
電子代工服務營業收入淨額	239,519	100.0%	204,723	100.0%	17%
營業毛利	21,479	9.0%	18,921	9.2%	14%
營業淨利 (淨損)	8,706	3.6%	7,802	3.8%	12%

*: 購買價格分攤費用係環電收購Asteelflash會計處理認列之購買溢價，分攤至不動產、廠房及設備、無形資產、使用權資產及遞延所得稅負債，使資產或負債價值增加而產生之損益影響。排除購買價格分攤產生之折舊、攤銷、其它費用、所得稅利益及歸屬於非控制權益之淨利，於2021年第4季及第3季為新台幣0.6億及2021年為新台幣3.5億。

電子代工服務

產品應用別佔比

(未經會計師查核)



重要資產負債表項目及財務指標

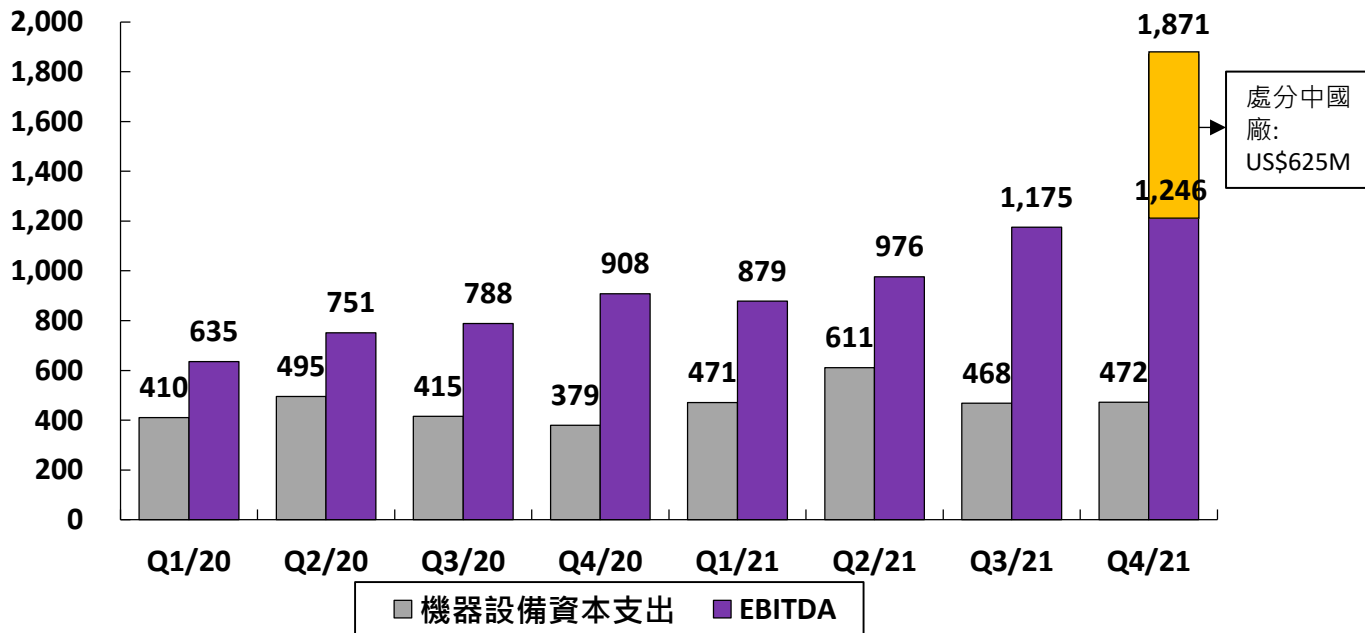
(未經會計師查核)

(新台幣百萬元)	2021/12/31	2021/9/30
現金及約當現金	76,073	53,419
金融資產 - 流動	3,075	4,133
金融資產 - 非流動及採用權益法之投資	23,260	20,915
不動產、廠房及設備	239,867	252,384
資產總計	672,934	650,259
短期借款	41,037	36,610
一年內到期之應付公司債	9,903	3,699
一年內到期之長期借款	4,526	2,840
應付公司債	42,365	48,498
長期借款及長期應付票券	121,946	137,015
附息負債總計	227,176	235,326
負債總計	398,301	399,420
權益總計 (含非控制權益)	274,633	250,839
當季 EBITDA	51,938	32,655
流動比率	1.39	1.35
負債權益比率	0.54	0.71

機器設備資本支出及EBITDA

(未經會計師查核)

美金百萬元



2021 業務概要

- **2021 營收及利潤之改善優於目標**

- 2021 封測事業營收年成長 26% (全部以美金計價), 或排除出口管制條例影響之生意量年成長 45%
- 2021 封測事業毛利率為 26.5%, 接近歷史高峰值 27%
- 2021 日月光合併營收年成長 26%
- 2021 日月光合併營業利益率較前一年進步 3.6 個百分點, 高於目標之 2.5 - 3 個百分點

- **廣泛的成長動能**

- 2021 打線營收年成長 36%, 期望 2022 雙位數成長
- 受到出口管制條例影響, 2021 測試營收仍年成長 12%, 期望 2022 成長率加倍
- 2021 先進封裝營收年成長 23%, 期望 2022 更強勁的成長率
- 2021 封測事業汽車電子營收年成長超過 60%, 動能將在 2022 持續, 期待達到十億元美金營收的里程碑

註：全部數字係以美金計價，2021 數字以財報基礎表達，2022 數字及前瞻性評論為擬制性基礎計算而得，其不包含 2021 已處分之四個中國廠。

2022 展望 (1/2)

• 營收及利潤之改善 2022 仍將持續

- 需求強勁的 2022, 預期將伴隨著另一個優於季節性的 2022 第一季, 第二季將優於第一季
- 期望邏輯半導體產業年成長 5-10%
- 在市佔率增加及整合元件製造廠外包的驅動下, 期望 2022 半導體封測事業營收年成長為邏輯半導體產業之 2 倍
- 期望一個價格穩定的環境, 及更多測試生意與先進封裝生意的組合
- 擴大 SiP 客戶組合, 新 SiP 客戶之營收在 2022 突破五億美金大關
- 2022 封測事業毛利率及營業利益率應突破 2014 之歷史高峰 (27.0%/16.6%)。合併營業利益率將較 2021 更進一步成長。

註：全部數字係以美金計價，2022 數字及前瞻性評論為擬制性基礎計算而得，其不包含 2021 已處分之四個中國廠。

2022 展望 (2/2)

- 2022 及之後將有穩健的前景
 - 產能及供應鏈限制將持續至 2023 以後
 - 規模、領先技術、靈活性及過去的經營實績證明日月光為一個不可或缺的製造夥伴
 - 客戶長期服務之協議延伸至 2023
 - 整合元件製造廠外包率正加速中
 - 健全成長的高效能運算、汽車電子、5G、IoT 及晶片含量增加將導向強勁的終端需求及樂觀的長期前景
 - 2021 開始的新一回合智慧工廠、建築及基礎建設投資旨在支持客戶的長期需求

處分中國廠

- 交易完成於 2021 年 12 月 16 日
- 總價金：美金 14.6 億元
- 處分之工廠佔封測營收 7.6%，佔合併營收 4.5%
- 處分之工廠在 2021 供獻約新台幣 0.79 元之基本每股盈餘
- 資源調整至主要廠區 (矽品蘇州) 來強化中國商機
- 更多的現金資源來投入有機擴張與戰略投資

2022年第一季業績展望*

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光投控2022年第一季的業績展望如下：

- 擬制性基礎下，以美金計價，相比去年第四季，封測事業今年第一季生意量將受到較少工作天數與SiP季節性波動之影響達4%；
- 擬制性基礎下，封測事業今年第一季毛利率將略高於去年第二季毛利率；
- 以美金計價，電子代工服務今年第一季生意量將與去年整年之季度平均相仿；
- 電子代工服務今年第一季營業利益率將接近去年第二季與第三季之平均。

*: 受2019年新型冠狀病毒疫情的影響，我們的前景持續承受較高的風險。此次簡報我們所提供的營運及財務資訊為截至本次營運報告發佈日期我們當前觀點的參考依據。我們的業務、財務狀況或營運結果可能面臨更大的不利風險，因此，可能提高預期與實際結果之間存在重大差異的可能性。

Thank You

www.aseglobal.com



附件1

合併綜合損益表

擬制性基礎

(未經會計師查核)

(新台幣百萬元)	Q1/2021	%	Q2/2021	%	Q3/2021	%	Q4/2021	%	FY/2021	%
營業收入淨額:										
半導體封測事業	65,557	57.6%	70,919	58.8%	82,019	57.0%	83,805	50.4%	302,300	55.5%
電子代工服務	47,684	41.9%	49,147	40.7%	61,116	42.5%	81,541	49.1%	239,488	44.0%
其它	602	0.5%	619	0.5%	758	0.5%	812	0.5%	2,791	0.5%
營業收入淨額合計	113,843	100.0%	120,685	100.0%	143,893	100.0%	166,158	100.0%	544,579	100.0%
營業毛利	20,868	18.3%	23,470	19.4%	29,251	20.3%	31,454	18.9%	105,043	19.3%
營業淨利 (淨損)	10,405	9.1%	12,394	10.3%	17,463	12.1%	18,765	11.3%	59,027	10.8%
稅前淨利 (淨損)	10,625	9.3%	12,440	10.3%	17,429	12.1%	36,320	21.9%	76,814	14.1%
所得稅利益 (費用)	(2,392)	-2.1%	(2,543)	-2.1%	(3,505)	-2.4%	(5,767)	-3.5%	(14,207)	-2.6%
非控制權益	(252)	-0.2%	(358)	-0.3%	(668)	-0.5%	(828)	-0.5%	(2,106)	-0.4%
歸屬於本公司業主之淨利	7,981	7.0%	9,539	7.9%	13,256	9.2%	29,725	17.9%	60,501	11.1%
基本每股盈餘 (新台幣元)	1.85		2.21		3.07		6.92		14.05	
稀釋每股盈餘 (新台幣元)	1.80		2.12		2.99		6.72		13.62	
USD/NTD	28.30		28.03		27.79		27.78		27.98	

*:擬制性基礎不包含已處分之四個中國廠。

附件2

綜合損益表 – 半導體封裝測試

擬制性基礎

(未經會計師查核)

(新台幣百萬元)

營業收入淨額:

	Q1/2021	%	Q2/2021	%	Q3/2021	%	Q4/2021	%	FY/2021	%
封裝	56,844	83.4%	60,716	83.5%	69,512	83.4%	70,942	83.3%	258,014	83.4%
測試	10,204	15.0%	10,656	14.6%	12,354	14.8%	12,700	14.9%	45,914	14.9%
材料直接銷售	1,044	1.5%	1,372	1.9%	1,429	1.7%	1,502	1.8%	5,347	1.7%
其它	47	0.1%	3	0.0%	26	0.0%	36	0.0%	112	0.0%
營業收入淨額合計	68,139	100.0%	72,747	100.0%	83,321	100.0%	85,180	100.0%	309,387	100.0%
營業毛利	16,989	24.9%	18,876	25.9%	23,181	27.8%	24,301	28.5%	83,346	26.9%
營業淨利 (淨損)	9,415	13.8%	11,048	15.2%	14,667	17.6%	15,205	17.9%	50,334	16.3%
USD/NTD	28.30		28.03		27.79		27.78		27.98	

*:擬制性基礎不包含已處分之四個中國廠。

附件3 合併綜合損益表

(未經會計師查核)

(新台幣千元)	Q1/2021	Q2/2021	Q3/2021	Q4/2021	FY/2021
營業收入	119,469,784	126,926,346	150,664,816	172,936,186	569,997,132
營業成本	97,583,415	102,122,197	119,880,851	140,041,892	459,628,355
帳列營業成本項下之購買價格分攤費用	1,024,525	933,946	931,880	925,188	3,815,539
營業毛利	21,886,369	24,804,149	30,783,965	32,894,294	110,368,777
營業毛利-不含購買價格分攤費用	22,910,894	25,738,095	31,715,845	33,819,482	114,184,316
營業費用	10,977,703	11,630,191	12,357,669	13,278,865	48,244,428
帳列營業費用項下之購買價格分攤費用	269,154	263,543	262,097	261,699	1,056,493
營業淨利	10,908,666	13,173,958	18,426,296	19,615,429	62,124,349
營業淨利-不含購買價格分攤費用	12,202,345	14,371,447	19,620,273	20,802,316	66,996,381
營業外收入(支出)	271,633	170,726	48,235	17,720,464	18,211,058
帳列營業外收入/(支出)項下之購買價格分攤費用	43,225	2,813	39,929	40,799	126,766
營業外收入/(支出)-不含購買價格分攤費用	314,858	173,539	88,164	17,761,263	18,337,824
稅前淨利	11,180,299	13,344,684	18,474,530	37,335,892	80,335,405
帳列稅前淨利項下之購買價格分攤費用總額	1,336,904	1,200,302	1,233,906	1,227,686	4,998,798
稅前淨利-不含購買價格分攤費用	12,517,203	14,544,986	19,708,436	38,563,578	85,334,203
所得稅費用	2,451,096	2,648,128	3,630,545	5,592,057	14,321,826
帳列所得稅費用項下之購買價格分攤費用	(38,471)	(16,250)	(20,612)	(21,430)	(96,773)
所得稅費用-不含購買價格分攤費用	2,489,567	2,664,378	3,651,157	5,613,487	14,418,599
非控制權益淨利	252,076	358,136	667,705	827,984	2,105,901
帳列非控制權益淨利項下之購買價格分攤費用	30,714	12,788	15,661	16,695	75,858
非控制權益淨利-不含購買價格分攤費用	282,790	370,924	683,366	844,679	2,181,759
歸屬於本公司業主之淨利	8,477,127	10,338,420	14,176,280	30,915,851	63,907,678
帳列歸屬於本公司業主之淨利項下之購買價格分攤費用	1,267,719	1,171,264	1,197,633	1,189,561	4,826,167
歸屬於本公司業主之淨利-不含購買價格分攤費用	9,744,846	11,509,684	15,373,913	32,105,412	68,733,845
購買價格分攤費用總額	1,298,433	1,184,052	1,213,294	1,206,256	4,902,025
基本每股盈餘(新台幣元)	1.97	2.40	3.29	7.20	14.84
基本每股盈餘(新台幣元)-不含購買價格分攤費用	2.26	2.67	3.56	7.48	15.96
稀釋每股盈餘(新台幣元)	1.92	2.30	3.20	6.99	14.40
稀釋每股盈餘(新台幣元)-不含購買價格分攤費用	2.21	2.57	3.47	7.27	15.50